

光回路実装技術(OPT)研究会 第87回OPT公開研究会

主催: 光回路実装技術研究会
協賛: IEEE EPS Japan Chapter

◆公開研究会のご案内

光回路実装技術(OPT)研究会では、第87回OPT公開研究会を開催します。

今回は、「マルチコアファイバ技術が拓く近未来像とその最新技術 ~高密度化の壁を突破する空間多重技術:マルチコアファイバの可能性~」を報告します。

AI技術の普及による光ネットワークにおける通信トラフィックの急速な増大に伴い、既存の光ファイバでも高速・大容量通信の限界が近づいている中、この限界を突破するための新しい光伝送技術として、マルチコアファイバを中心とする研究開発が活発に行われています。本講演会では、マルチコアファイバによる光通信の近未来像を俯瞰した後、最新の研究成果について、大容量通信技術からデータセンターに応用できる高密度実装技術まで、著名な講師の方々からご講演をいただきます。また、本技術分野関連の各企業・教育機関による展示も開催します。

開催日時 2025年7月18日(金) 13:20~18:00

開催方式 ハイブリッド研究会 (対面(古河電気工業本社)とZoom Webinar)

開催場所: 古河電気工業株式会社 本社 Gallery1~4

東京都千代田区大手町2丁目6番4号(常盤橋タワー)

[JR最寄り駅: 東京駅]

※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します

13:20~13:30

ご挨拶 光回路実装技術委員会委員長 松岡 康信(日本ルメンタム株式会社)
第87回 OPT公開研究会の企画説明 長瀬 亮(情報通信研究機構)

13:30~14:15



「光空間多重技術の創生と進展」(オンライン講演)

デンマーク工科大学 盛岡 敏夫 教授

(要旨)

2008年頃の光空間多重技術創成期に、問題提起した課題、構想した新技術、目標を振り返り、光空間多重用の新規伝送路、光増幅技術、光接続技術、光伝送技術などの現在までの進展と今後の展望を概説する。

14:15~14:50



「Pbit/s級光トランスポートネットワークのためのモード多重光伝送技術」

日本電信電話株式会社 宮本 裕 氏

(要旨)

将来のPbit/s級光トランスポートネットワークの経済的な実現にむけて、標準クラッド外径を有するマルチモードファイバを用いて空間多重度を10以上に向上可能な大容量長距離モード多重光伝送システムが期待されている。本稿では、伝送装置・伝送媒体両面における技術課題と要素技術に関して最近の進展と展望について解説する。

15:05~15:40



「マルチコアファイバとVCSELアレイを用いた超小型・大容量CPOTランシーバ」
古河電気工業株式会社 長島 和哉 氏

(要旨)

光ランシーバの小型化・大容量化を実現するため、マルチコアファイバ (MCF)とVCSELの結合技術が研究されている。これらの動向と、我々が開発した19コアMCFを用いた超小型のVCSELランシーバについて講演する。

15:40~16:15



「自己形成光導波路によるマルチコアファイバ間接続およびFan-outデバイスの作製」
Orbray株式会社 行川 毅 氏

(要旨)

マルチコアファイバ接続には従来より高精度なアライメント技術が必要である。本講演ではアライメント緩和効果が期待できる自己形成光導波路技術を用いたマルチコアファイバ間接続とFan-outデバイス作製について報告する。

16:15~16:50



「マルチコアファイバの実用化に向けた標準化の動向」
国立研究開発法人 情報通信研究機構 境目 賢義 氏

(要旨)

長年の使用実績から高い信頼性を有する既存の光ファイバをベースとした、標準外径のマルチコアファイバ(MCF)は、実用化に最も近い次世代の光ファイバとして地位を確立しつつある。本公演ではMCFの実用化を目指して活動している標準化団体とその活動動向について概説する。

17:00~18:00 オーサーインタビュー(ポスター)セッション+展示(関連分野企業・教育機関)

※プログラムは変更になることがありますので、ご了承ください。
※当日は研究会活動の紹介として、過去に発刊したロードマップの冊子について展示予定です。

参加要項

定員 古河電気工業株式会社本社現地:120名, Web: 150名 (共に先着申込順)

参加費 (消費税込み。現地参加, Web参加共に同額)

JIEP正会員, 賛助会員, IEEE EPS会員:5,000円, 研究会会員:別払い

JIEP学生会員, IEEE EPS学生会員, JIEP名誉会員, 賛助会員(クーポン利用):無料

JIEPシニア会員:1,000円

非会員一般:10,000円, 非会員学生(資料あり):1,000円, 非会員学生(資料なし):無料

配布資料 研究会講演資料(研究会前日にPW付きファイル配信, 当日に開封PWご連絡)

注意事項(参加方法)

- ①申込が受理され次第、返信メールで公開研究会参加URLやお支払いに関する情報をご連絡致します。
- ②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。
(お支払い方法:クレジットカード決済・コンビニ決済)(手数料 学会負担)
- ③領収書(宛名会社名選択可)のご発行は、返信メールのマイページから決済後に即日出力が可能です。
- ④WEBの領収書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。
- ⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入が必要となります。
*キャンセルポリシー お申込み後のキャンセルはできません。

下記から参加申し込みをお願いします

会員

賛助会員

協賛会員

非会員

※クーポン使用の場合は「クーポン利用」をご選択ください。

問い合わせ先 一般社団法人エレクトロニクス実装学会

E-mail:opt_member<at>jiep.or.jp 送信時は<at>を@に変えてください。